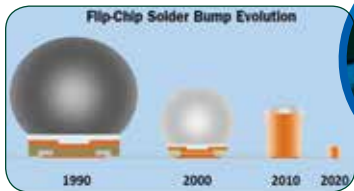


极低残留免洗 倒装焊助焊剂



- 铜柱或标准凸块
- 适用于高锡合金
- 回流后残留极低
- 无卤
- 免洗
- 残留物与底部填充胶兼容



china@indium.com

ISO 9001
REGISTERED

表格编号: 99639 R0
©2019 钢泰公司

INDIUM
CORPORATION®

极低残留免洗 倒装焊助焊剂

	NC-699	NC-26-A	NC-26S	常见的倒装焊助焊剂
回流后残留物比重典型值 (TGA 数据)	<2%	~5%	<10%	40-60%
可焊性				
残留物级别				
可轻松地用CUF/MUF进行底部填充				
与CUF/MUF的兼容性				
回流过程中粘住大芯片的能力				
被主流OSAT/ODM大量用于轻薄设备	记忆体	逻辑体	逻辑体	

主要使用对象

- ASIC芯片
- 记忆体
- SAW 滤波器
- 功率 QFN



china@indium.com

ISO 9001
REGISTERED

表格编号: 99639 R0
©2019 钢泰公司

